

## <<RF MEMS应用指南>>

### 图书基本信息

书名：<<RF MEMS应用指南>>

13位ISBN编号：9787121017506

10位ISBN编号：7121017504

出版时间：2005-11

出版时间：电子工业出版社

作者：瓦达

页数：300

字数：496000

版权说明：本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问：<http://www.tushu007.com>

## <<RF MEMS应用指南>>

### 内容概要

本书主要内容包括：微机电系统和射频、MEMS材料和制造工艺、RF开关与微型继电器、MEMS电感和电容、微电机RF滤波器、微机械移相器、微机械传输线及部件、微机械天线、RF MEMS的集成与封装。

本书可供从事微制造技术的人员阅读，也可作为相关专业人员的参考用书。

## &lt;&lt;RF MEMS应用指南&gt;&gt;

## 书籍目录

第1章 微机电系统 (MEMS) 和射频MEMS	1.1 引言	1.2 MEMS	1.3 MEMS的微制造	1.3.1 硅的
本体微机械	1.3.2 硅的表面微机械	1.3.3 MEMS模片焊接	1.3.4 LIGA工艺	1.3.5 聚合
物MEMS部件的微机械	1.3.6 三维结构的微制造	1.4 机电换能器	1.4.1 压电换能器	1.4.2 电
致伸缩换能器	1.4.3 磁致伸缩换能器	1.4.4 静电执行器	1.4.5 电磁换能器	1.4.6 电动换能
器	1.4.7 电热执行器	1.4.8 各种电子机械致动方案比较	1.5 MEMS中的微型传感	1.5.1 压阻
传感	1.5.2 容性传感	1.5.3 压电传感	1.5.4 谐振传感	1.5.5 声表面波传感器
1.6 MEMS	1.6.1 MEMS用的金属及金属氧化物	1.6.2 MEMS用的聚合物	1.6.3 MEMS用的其他	
材料	1.7 本书的涉及范围	参考文献第2章 MEMS材料和制造工艺	2.1 金属	2.1.1 蒸发
2.1.2	溅射	2.2 半导体	2.2.1 电性能和化学性能	2.2.2 生长和淀积
2.3 MEMS薄膜以及淀积方法	2.3.1 热氧化形成的氧化物膜	2.3.2 二氧化硅和氮化硅的淀积	2.3.3 多晶硅薄膜淀积	2.3.4
2.3.4	铁电薄膜	2.4 MEMS系统中的聚合物材料	2.4.1 聚合物的分类	2.4.2 紫外线辐射固化
2.4.3	MEMS中的SU-8聚合物	2.5 硅基MEMS的体微机械加工	2.5.1 各向同性和方向相关的湿法刻蚀	
2.5.2 干法刻蚀	2.5.3 掩埋氧化物工艺	2.5.4 硅熔融键合	2.5.5 阳极键合	2.6 硅表面微机
2.6 硅表面微机	2.6.1 牺牲层工艺	2.6.2 牺牲层工艺中的材料系统	2.6.3 离子刻蚀的表面微机械加工	
2.6.4 与集成电路技术结合和各向异性湿法刻蚀	2.7 聚合物MEMS的微立体平版印刷术	2.7.1 扫描微立体平版印刷技术	2.7.2 双光子微立体平版印刷术	2.7.3 聚合物MEMS的表面微
2.7.4 投影方法	2.7.5 聚合物与硅、金属、陶瓷综合架构的MEMS	2.7.6 微立体平	2.7.6 微立体平	版印刷术与薄膜平版印刷术的整合
2.8 结论	参考文献第3章 RF开关与微型继电器	3.1 引言	3.2	开关的参数
3.3 开关基础知识	3.3.1 机械开关	3.3.2 电子开关	3.4 开关在RF和微波中的应用	
.....第4章 MEMS电感和电容	第5章 微机械RF滤波器	第6章 微机械移相器	第7章 微机械传输线及	部件
第8章 微机械天线	第9章 RF MEMS的集成与封装	参考文献		

<<RF MEMS应用指南>>

版权说明

本站所提供下载的PDF图书仅提供预览和简介，请支持正版图书。

更多资源请访问:<http://www.tushu007.com>